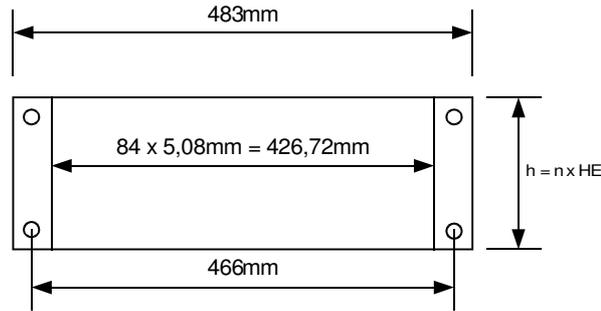


## Modularisierung



### 19“-Technik / Baugruppenträger:

- 483mm Außenseite
- Höhe in Höheneinheiten:           1HE = 1,75" = 44,45mm  
     üblich: 3HE=133,35mm  
           6HE=266,70mm
- Tiefe: 175mm,235mm,...475mm
- lichte Werte: 84 x 0,2" = 84 x 5,08mm = 426,7mm  
   darin bspw. 21 Baugruppen mit jeweils 20,3mm
- Europakarte:           100 x 160mm<sup>2</sup>     → Rack mit 3HE (133,35mm)
- Doppeleuropakarte: 233,35 x 160mm<sup>2</sup>   → Rack mit 6HE (266,7mm)

### Breite der Baugruppen:

- Raster 0,2"=5,08mm
- Höhe der Bauteile entsprechen der Breite der senkrecht eingeschobenen Baugruppe  
   → SMD auf Rückseite
- Temperatur, Störungen, Sicherheitsabstände
- Bauteile auf der Frontplatte sind durch die gewünschte Bedienungsfunktionen vorgegeben und bestimmen je nachdem die Breite der Baugruppe maßgeblich mit.  
   (bspw. Bedienungselemente, Ein-Ausgänge, Anzeigen,..)

### Verbindung der Baugruppen:

- Rückseite verdrahtet (Rückwandplatine / Backplane)
- direkte Steckverbindungen
  - PC-Technik, PCI-Bus
  - Kontaktfahnen auf der Leiterplatte
  - Buchsen mit Kontaktfedern
- indirekte Steckverbinder (DIN 41612)
  - Stecker auf der Leiterplatte (male)
  - Buchse auf Baugruppenträger (female)
- Bauformen nach DIN41612:

Bauform	B,C	E	H
Polzahl	32/64/96	48	01.11.15
Temperatur	-55°C bis +125°C		-65°C bis +125°C
Strom bei 70°C	1,1A	4A	11A
Spannung	1000V	1550V	3100V

- Leiterplattenstecker (Pfostenleisten)
- Goldauflage auf den Kontakten abhängig von Steckzyklen